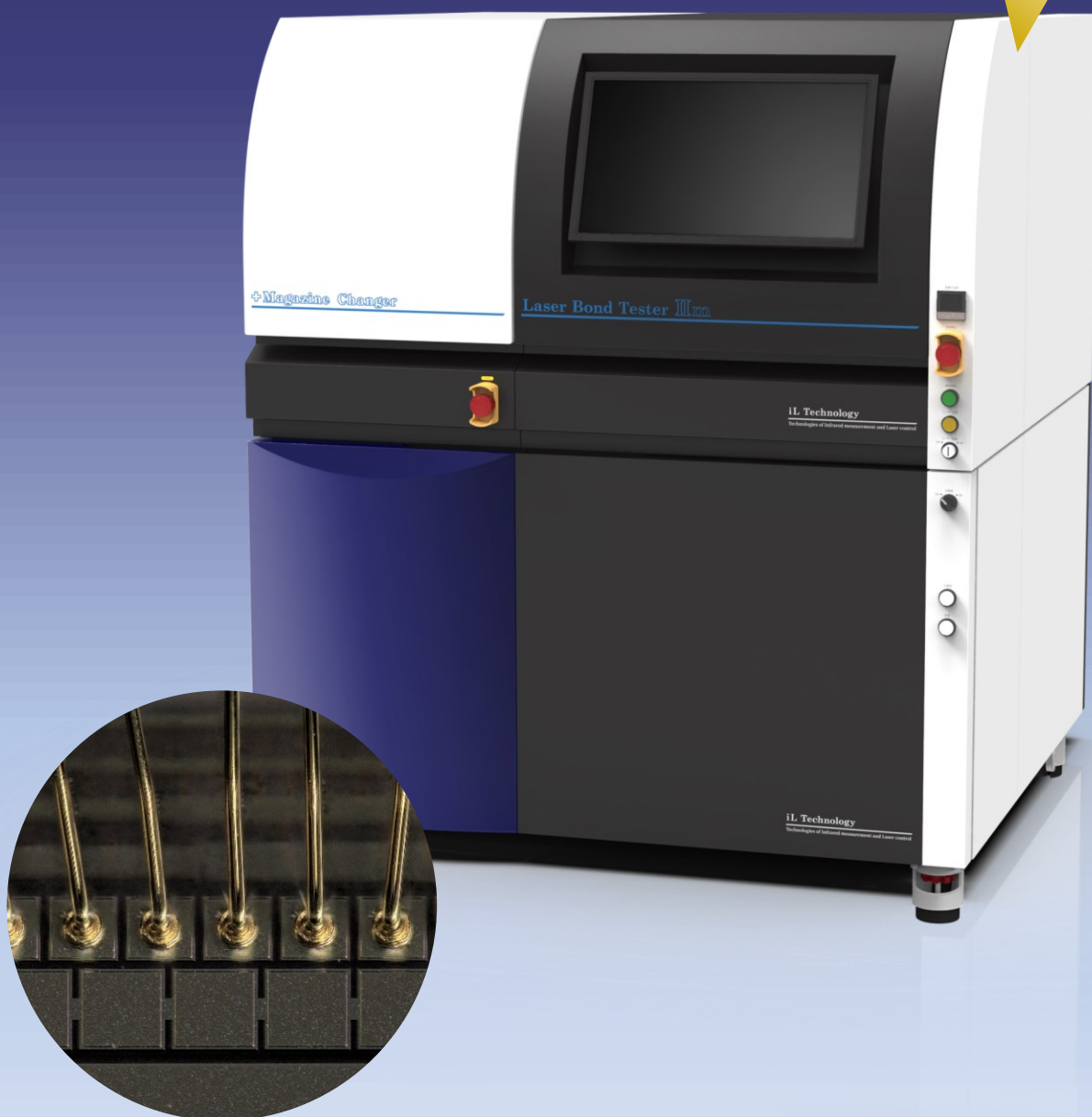


非破壊

レーザーボンドテスター

Laser Bond Tester II + Magazine Changer

業界初！



< 全自動測定 >

金ワイヤボンドの 非接触 非破壊 瞬時測定 を初実用化！

iL Technology

Technologies of Infrared measurement and Laser control

Ver.1.0

概要仕様

測定方法	レーザー周期加熱式接合界面測定法 *3)
測定対象	金/銅 ワイヤ接合界面状態 *1) ワイヤ径: $\phi 15\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$
測定結果表示	接合面積及び接合係数(回帰定数を設定)、良否判定位相、時定数、位相変位グラフなど
測定時間	1~5秒/ボンド: 位置移動時間及び画像処理時間を含む 1ms~5ms/ボンド: 実測定時間
リードフレーム寸法	L: 300mm/max.・W150mm/max.・t: 2mm/max.
マガジン寸法	L: 305mm/max.・W160mm/max.・H: 175mm/max.
マガジnstock数	1個/シングルエレベーター
画像処理機能	最適測定位置認識機能
レシピ作成	操作画面入力・ティーチング入力・外部作成レシピ入力
レシピ機能	測定位置、測定条件、良否判定など
電源	三相AC200V 30A/max.、要接地(D種)
測定用レーザー	半導体レーザー *1) *2)
使用レーザークラス	クラス4: JIS C 6802 / IEC 60825 準拠
装置レーザークラス(通常運用時)	クラス1相当
装置安全基準	ISO13849 / JIS B 9705 準拠
装置本体外形寸法	W: 1300mm・D: 1280mm・H: 1534mm *4) (暫定仕様)
重量	約400kg (暫定仕様)
動作環境	温度: 20~30°C・湿度: 85%RH以下・粉塵無き事

- ※1) 測定対象毎に測定条件や加熱レーザーの調整などが必要です。
 ※2) 本装置のレーザーはクラス4製品です。ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けて下さい。
 ※3) 測定方法は、株式会社ジェイテクトの Patent に基づいています。
 ※4) 外形寸法は突起部を含みません。筐体部分のみの寸法で、上部のノット寸法は含まれていません。
 ※5) 本装置は温度調整ユニット用に工業用純水が必要です。(内部循環式)
 ※6) 本装置は機能・性能向上の為、お断りなく仕様が変更される場合があります。
 ※7) “レーザーボンドテスター”及び“Laser Bond Tester”は、アイエルテクノロジー株式会社の登録商標です。



販売代理店



株式会社 南陽

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19番8号

TEL: 092-473-7711

URL: <https://www.nanyo.co.jp>

製造元

iL Technology Corporation

アイエルテクノロジー株式会社

愛知県岡崎市針崎1丁目1番地13

TEL: 0564-73-2005

URL: <http://www.il-tech.jp>